

免責聲明

本次法說會提供之簡報包含前瞻性陳述，內容包含本公司財務狀況、未來擴張計劃及公司策略等訊息。此前瞻性陳述係基於本公司目前可得資訊對未來事件的期望和預測，儘管本公司認為該期望和預測具合理性，但此類前瞻性聲明仍涉及風險及不確定性。

鑒於這些風險、不確定性及假設，前瞻性事件可能不會發生，且本公司實際結果可能與這些前瞻性聲明中的預期存在重大差異。若因未來實際結果與預期狀況有重大差異，須公開更新或修改任何前瞻性陳述，本公司將不承擔此責任。

牧德科技法人說明會

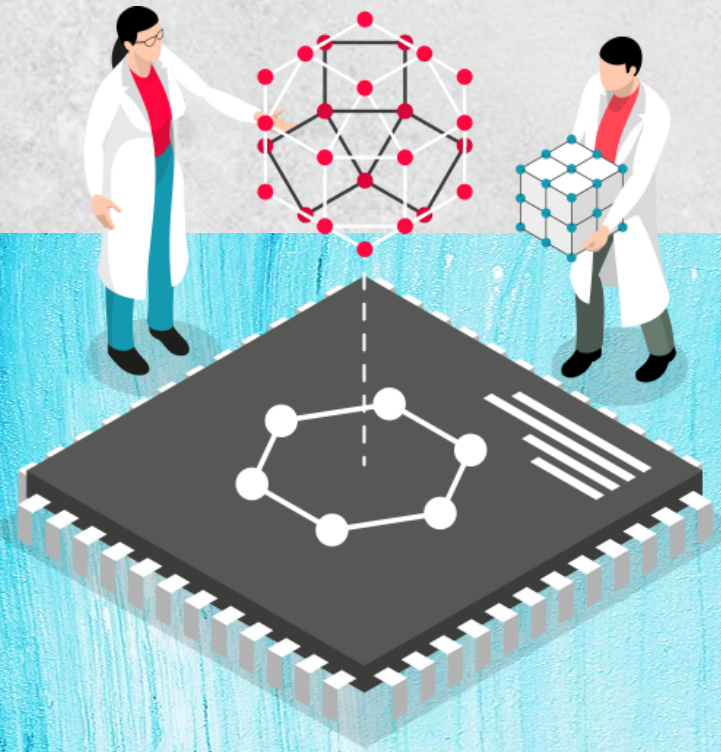
(3563 TT)

汪光夏 董事長

陳復生 總經理

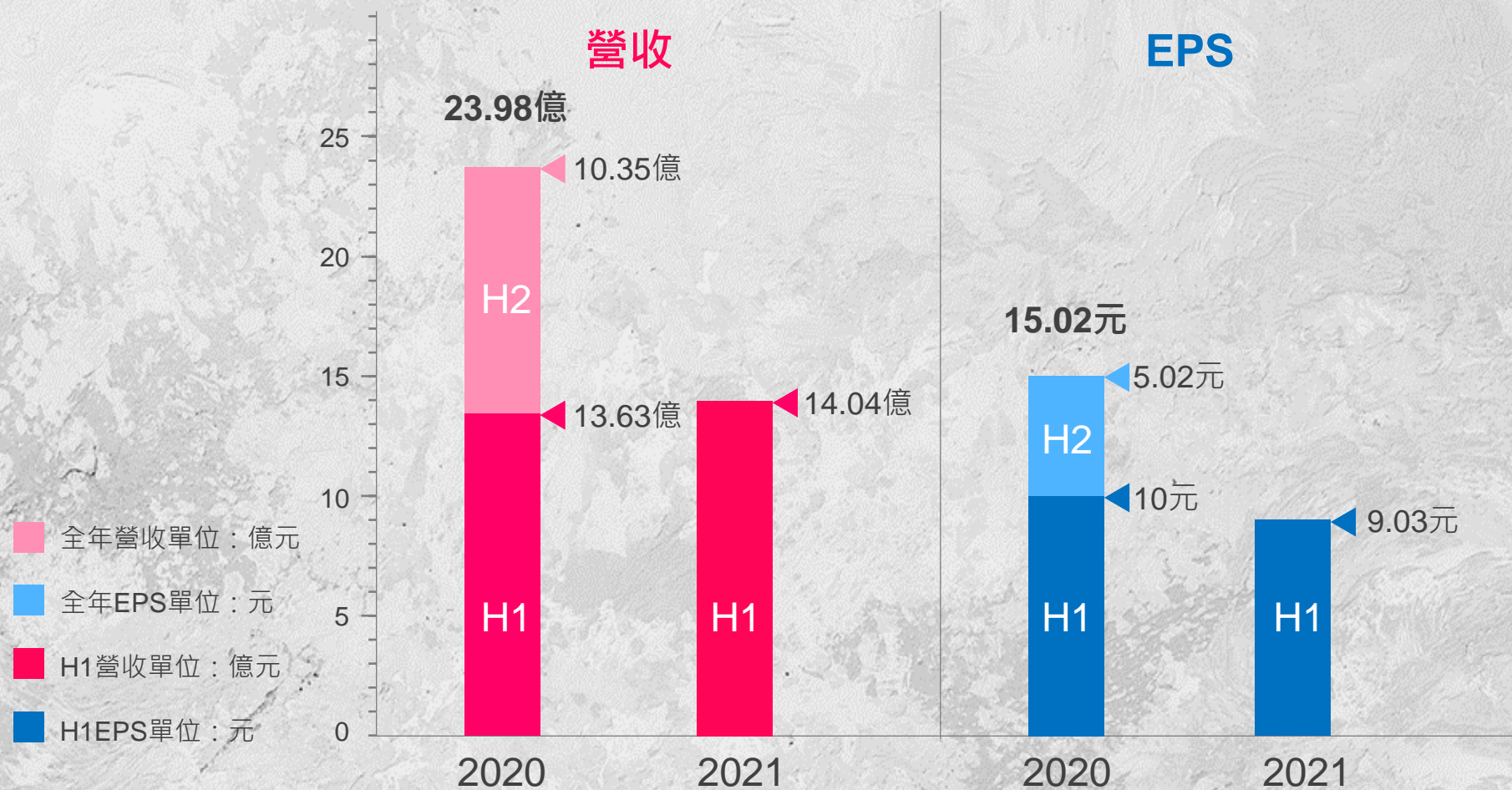
2021 / 08 / 24

- 2021 H1 營業成績
- 2021 H2 營業展望



2021 H1 營業成績

2020 與 2021 H1 營收與EPS比較圖



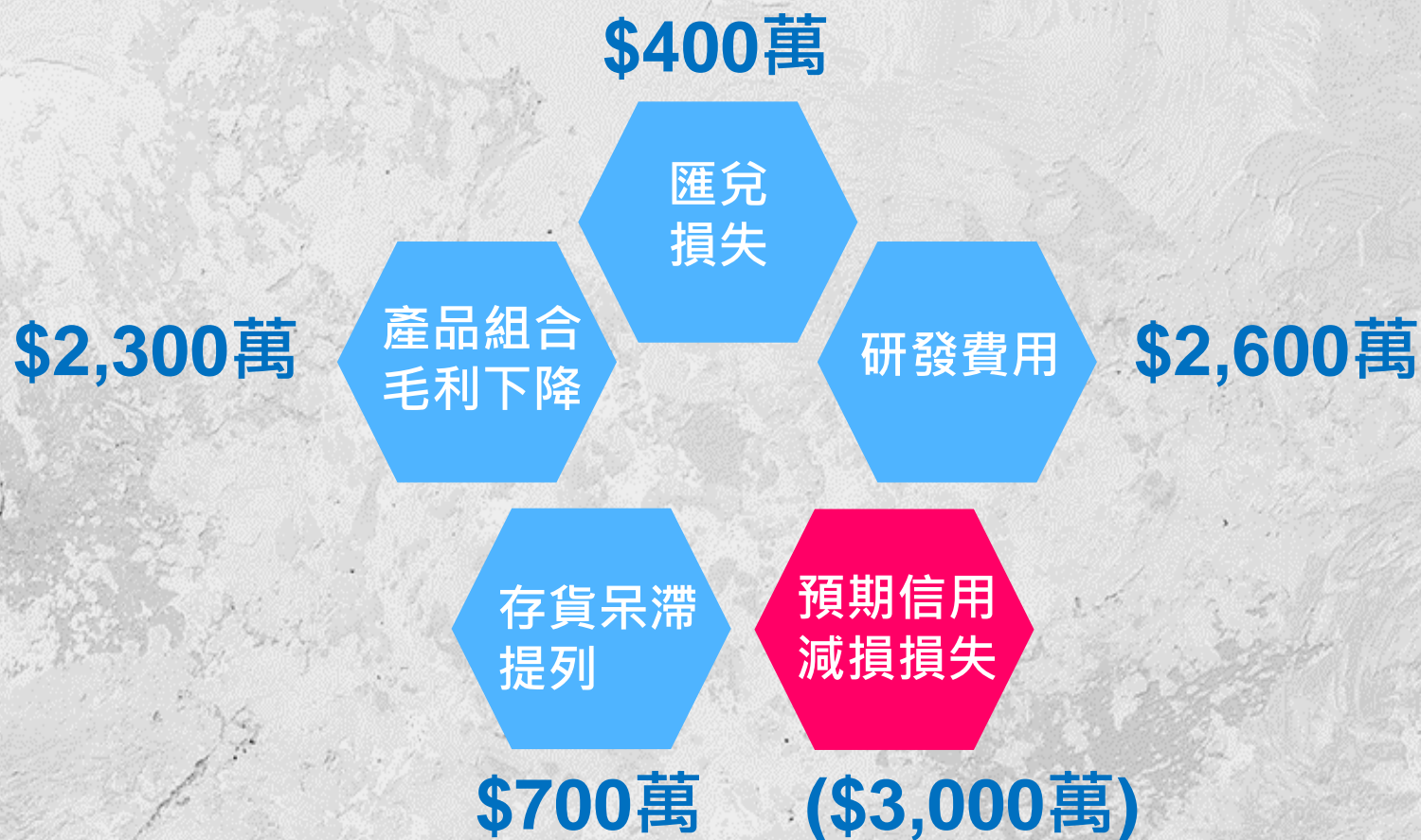
2021 H1 營業成績

毛利率與淨利率比較表

	2020	2020 H1	2021 H1
毛利率	63%	66%	62%
淨利率	27%	32%	28%

2021 H1 淨利率

2020 H1 與 2021 H1 淨利率差異分析



2020 股利發放



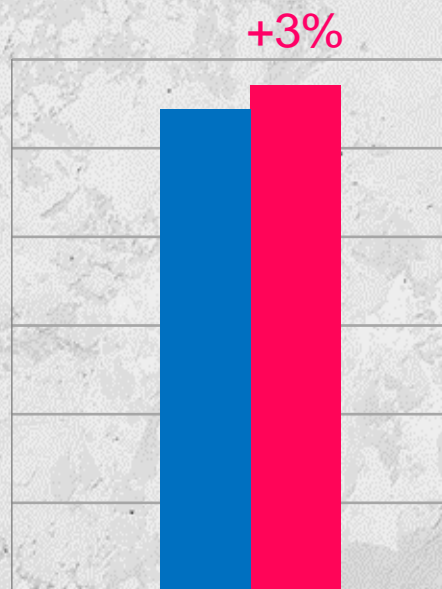
2020/11/25 已發放2020H1現金股利3元

2021/8/13 已發放資本公積現金股利9元

2020盈餘共配息12元

2021 H1 業務檢討

■ 2020 H1 Revenue ■ 2021 H1 Revenue



營收

台灣(載板) ↗

國際 ↘

中國 →

2021 H2 營業展望



訂單能見度樂觀

營收穩健、營運效能提升

新產品開發

產品開發進度

設備	進度
Smart Camera	穩定出貨
PCB mini LED	穩定出貨
Wafer Packaging	強化3D功能，穩定出貨
Substrate & SLP	通過驗證，穩定出貨
INDEX CCD 4W Tester	持續驗證中

未來營業展望

電測機

陸資台資前三大

載板

陸資、錫球檢查、外觀檢查、線路檢查

軟板

組裝外觀檢查

半導體產品

優化產品、增加3D功能

Smart Camera

大型PCB客戶

Q & A

